

# 「半導体製造装置メーカーの挑戦 ～ 技術変化点、多角化・多様化した市場要求への対応 ～」

## 講師紹介



東京エレクトロン株式会社  
コーポレートイノベーション本部\_コア技術開発担当 GM  
Innovation X Lab. 部長

### 早川 崇 (はやかわ たかし)氏

米系半導体メーカーにて装置エンジニア、プロセスエンジニア業務を経て、'98年より東京エレクトロン(TEL)にて半導体製造装置の開発、プロセス開発に従事。その後、開発・マーケティングメンバとしてエッチング装置、枚葉成膜装置などの製品企画、また、自社複数製品を組み合わせたモジュール・インテグレーション開発を企画・推進。現在も TEL にて先端デバイスメーカーと開発初期からの協業を通して、新製品企画・開発を担務しております。

## 講演概要

IoT、AI、5G の普及やあらゆる産業のスマート化、自動運転の展開、生成 AI やバーチャルリアリティ (VR) の実用化など、かつてないスピードでデータ社会への移行が進む中、デジタル技術の活用が一段と広がっています。その根幹を支える半導体においては、さらなる大容量、高速、高信頼性、低消費電力など、技術革新への期待は留まるところを知りません。

半導体市場は、2030 年には 1 兆米ドルを超え、現在の市場の倍以上に成長すると予想されています。そんな半導体の技術革新を支えてきたのが半導体製造装置・検査装置です。ムーアの法則である 2 次元の微細化に則って高性能化と低コスト化を牽引してきましたが、

「微細化の限界」と言われ始めた 2010 年代から新たな技術の変化点が、業界の技術ロードマップにたくさん現れてきています。

この講演では、これからの半導体産業を俯瞰し、産業界の新たな技術へのチャレンジを紹介します。

## 開催概要

日時: 2024年9月4日(水) 15:30~16:15 (ものづくり賞受賞講演:16:15~17:30)

会場: 岡山大学 津島キャンパス A室(A21 講義室)

申込方法: [https://www.jspe.or.jp/supporting\\_member/#schedule](https://www.jspe.or.jp/supporting_member/#schedule)

または、右の QR コードからお申込み下さい。

参加費: 無料(会員、非会員を問いません)、 事前申込制



【連携企画】半導体製造装置シンポジウム : 10:00~12:40

同日 10:00~「半導体製造装置開発の最前線」と題して、同会場にてシンポジウムを開催します。

合わせてご参加ください。